

当社は次の会計方針および事業区分の変更を行っています。

- 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から、原則として設置完了基準に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、売上高は80,956百万円、営業利益は20,541百万円、税金等調整前当期純利益は20,563百万円減少しています。
- 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置に係る保証期間中のアフターサービス費用については、従来の支出時の費用処理から、過去の支出実績を基準にして算出した見積額を製品保証引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、2005年3月期は従来の方法に比べ、営業利益は635百万円、税金等調整前当期純利益は13,106百万円減少しています。
- 当社は、2006年10月1日付けにて、コンピュータ・ネットワーク部門を東京エレクトロデバイス株式会社に株式分割により移管しました。これに伴い、「産業用電子機器」セグメントに属していた「コンピュータ・ネットワーク」事業を、2007年3月期より「電子部品・情報通信機器」（旧「電子部品事業」）セグメントに区分変更しました。
- 2009年3月期より、従来のFPD製造装置部門をFPD/PV製造装置部門に名称を変更しました。当部門では、FPD製造装置に加えて、2008年より新規参入したPV（太陽電池）製造装置を取り扱っています。

損益状況

当期の概況

当期2009年3月期の世界経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した金融危機が世界的に広がり、景気が大きく後退しました。米国に加え、堅調な成長を続けていた欧州、さらには景気拡大の続いていたアジアでも急激に景気が減速し、世界経済は未曾有の同時不況の様相を呈しました。

当グループの参画するエレクトロニクス産業においては、景気悪化によりパソコンや携帯電話、デジタル家電などの電子機器の需要が低迷し、生産調整が行われました。それらに搭載される半導体デバイスの需要減少、価格下落の影響を受け、半導体メーカーの設備投資計画の延期や縮小が相次ぎました。

このような事業環境の中、当グループの業績は、主力の半導体製造装置部門の売上が著しく減少し、最高収益となった前期業績を大幅に下回る結果となりました。しかしながら、環境の変化に早めに対応し、2008年初頭から固定費削減を強化するなどの迅速な対策が功を奏し、通期で黒字を確保することができました。

	百万円				
	2005	2006	2007	2008	2009
売上高	¥635,710	¥673,686	¥851,975	¥906,092	¥508,082
売上総利益	175,913	189,732	272,649	311,298	137,408
売上総利益率	27.7%	28.2%	32.0%	34.4%	27.0%
販売費及び一般管理費	111,930	114,029	128,670	142,800	122,697
営業利益	63,983	75,703	143,979	168,498	14,711
営業利益率	10.1%	11.2%	16.9%	18.6%	2.9%
税金等調整前当期純利益	55,775	75,328	144,414	169,220	9,637
当期純利益	61,601	48,006	91,263	106,271	7,543

2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくは当セクションの冒頭にある記載をご参照ください。

売上の状況

当期の売上高は、前期比43.9%減少の5,081億円となり、ITバブル崩壊の影響を受けた2002年3月期の減収幅(42.3%減少)を上回りました。国内売上高は前期比35.5%減少の2,089億円、海外売上高は48.6%減少の2,992億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は64.2%から58.9%に低下しました。

また、当期の受注高は前期比50.9%減少の3,660億円、当期末の受注残高は43.7%減少の1,828億円となり、受注高、受注残高ともに2年連続で減少しました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比37.7%減少の3,707億円でしたが、売上原価率は73.0%となり、前期から7.4ポイント上昇しました。外注費等を始めとする製造固定費の削減に取り組みましたが、特に期後半からの工場稼働率の大幅な低下により製造固定比率が上昇しました。売上総利益は55.9%減少の1,375億円、売上総利益率は前期の34.4%から27.0%に低下しました。

販売費及び一般管理費は、経費削減に取り組んだ結果、前期比14.1%減少の1,227億円となりましたが、連結売上高に対する比率は前期の15.8%から24.1%に上昇しました。これらの結果、営業利益は前期比91.3%減少の147億円、営業利益率は前期の18.6%から2.9%に低下しました。

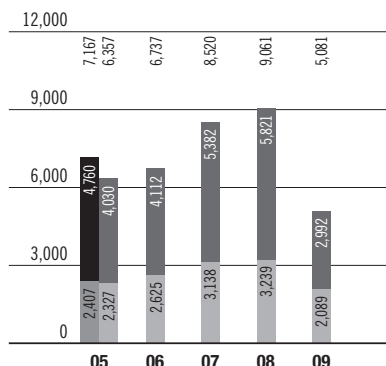
研究開発費

研究開発費は、販売費及び一般管理費に含まれます。研究開発費は将来の成長の源泉であるとの考えのもと、前期比7.7%減少の610億円を投じ、厳しい環境下ではありましたが高水準を維持しました。

分野別に見ると、半導体製造装置では、半導体デバイスの微細化への対応のみならず、さらなる高速化、低消費電力化を実現するための新材料への対応が求められており、優れた特性を持つRLSA*プラズマソースを使用する装置開発など、これらの要求に応える新技術、新製品の開発に取り組みました。また、こうした既存分野における技術開発のみならず、有機EL製造向け装置開発、太陽電池製造向け装置開発など、新規事業領域への開発投資も行いました。

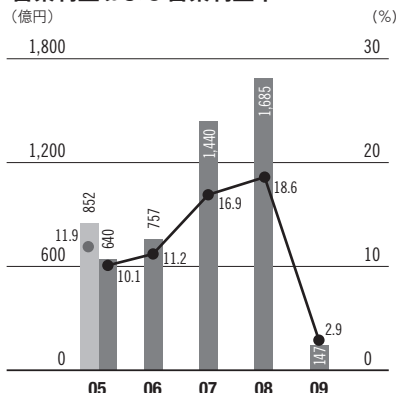
*RLSA: Radial Line Slot Antenna (低電子温度を特徴とする新プラズマ源)

国内および海外売上高
(億円)



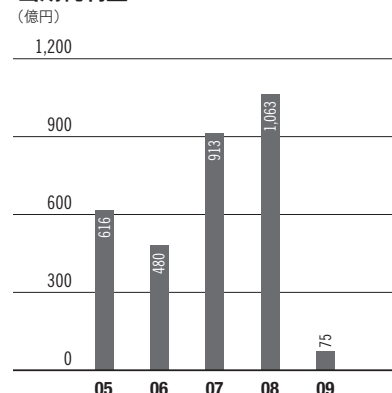
■ 国内(旧会計方針)
■ 海外(旧会計方針)
■ 国内(新会計方針)
■ 海外(新会計方針)

営業利益および営業利益率



■ 営業利益(旧会計方針)
● 営業利益率(旧会計方針)
■ 営業利益(新会計方針)
● 営業利益率(新会計方針)

当期純利益



その他収益(費用)および当期純利益

当期は、貸倒引当金繰入額74億円、投資有価証券評価損24億円を計上したことなどにより、その他収益(費用)はネットでマイナス51億円となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は前期比94.3%減少の96億円となりました。

当期純利益は前期比92.9%減少の75億円となり、1株当たり当期純利益は前期の594.01円から42.15円となりました。

配当政策および当期配当金

当社は、業績連動型・収益対応型の配当を行うことを株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途とする配当を実施しています。当期の1株当たりの配当金については、中間配当20円に期末配当4円を加えて24円とさせていただきます。配当政策をそのまま適用すれば、下半期に純損失を計上するため期末配当は無配となりますが、株主還元継続の観点から、1株につき4円を配当することといたしました。

なお、内部留保資金につきましては、研究開発投資、設備投資、海外展開などに有効活用し、業容拡大と利益成長を通して株主の皆様のご支援にお応えしていきます。

セグメント別の状況

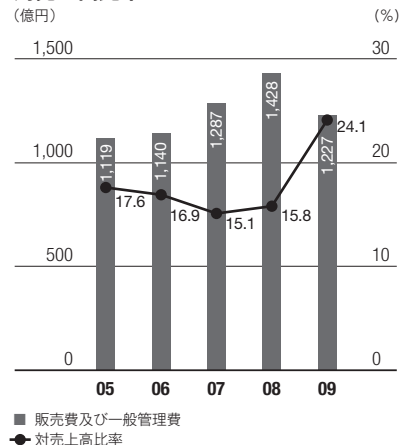
産業用電子機器事業

当セグメントの売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)は、前期比47.9%減少の4,148億円となりました。営業利益は92.2%減少の128億円、営業利益率は前期の20.7%から3.1%に低下しました。また、当セグメントの外部顧客に対する売上高は、前期比47.9%減少の4,139億円でした。

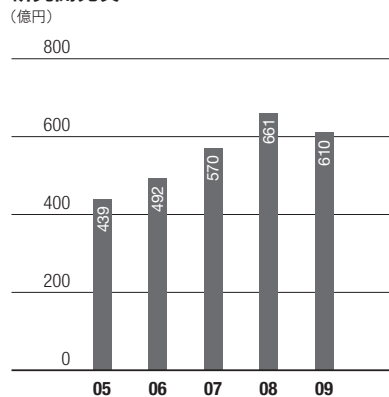
■ 半導体製造装置

半導体メモリ製品の市況の悪化および半導体デバイスに対する世界的な需要後退による大幅な設備投資抑制を背景に、半導体製造装置市場が著しく縮小し、当事業の外部顧客に対する売上高は前期比55.2%減少の3,254億円となりました。

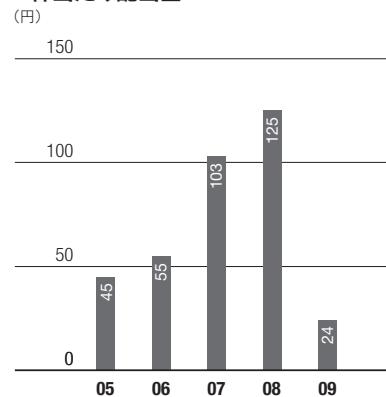
販売費及び一般管理費および対売上高比率



研究開発費



1株当たり配当金



売上を地域別に見ると、全地域において減収となりましたが、特に台湾向けの売上が前期比80.7%減少と大幅に縮小しました。

当期、市場に投入した新製品としては、コータ/デベロッパの高生産性新モデル「CLEAN TRACK® LITHIUS Pro® V」、高生産性及び環境負荷低減を可能とした枚葉プラズマ処理装置「Trias® SPAi」、さらなる高性能化を実現した新型スクラパー装置「NS300+」などがありました。また、NANDフラッシュメモリから導入が始まるダブルパターンニング技術を当社の一連の装置を使用して確立・実証しました。

なお、当事業の受注高は、期後半からの急減速により前期比57.4%減少の2,145億円、期末の受注残高は60.0%減少の738億円となりました。

■ FPD/PV (フラットパネルディスプレイおよび太陽電池) 製造装置*

当期は薄型テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資が堅調に進み、当事業の外部顧客に対する売上高は前期比29.5%増加の881億円となりました。しかしながら、パネル市況が夏以降に急速に悪化したことを受けて、受注環境は低調なものとなりました。

地域別では、韓国、台湾で売上が大幅に増加しました。また、期後半より第10世代のガラス基板に対応する装置の出荷を開始しました。

PV (太陽電池) 製造装置分野については、シャープ株式会社との合併会社において薄膜シリコン太陽電池用CVD装置の開発を進める一方で、2009年2月にスイスの太陽電池製造装置メーカーであるOerlikon Solar (エリコンソーラー) 社のアジア・オセアニア地域での独占販売代理店となる契約を結ぶなど、事業基盤の構築に努めました。

なお、当事業の受注高は、期後半からの急減速により前期比53.4%減少の606億円、期末の受注残高は21.7%減少の996億円でした。

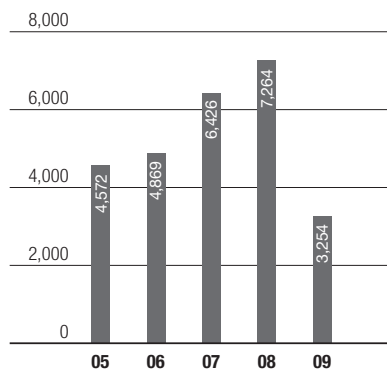
* 2009年3月期から、当部門の名称を「FPD (フラットパネルディスプレイ) 製造装置」から「FPD/PV (フラットパネルディスプレイおよび太陽電池) 製造装置」に変更しています。

■ その他

その他の売上は、主に損害保険代理業務、旅行代理業務などの内部サービス関連業務の売上です。当部門の外部顧客に対する売上高は前期比15.4%減少の4億円でした。

半導体製造装置売上高

(億円)

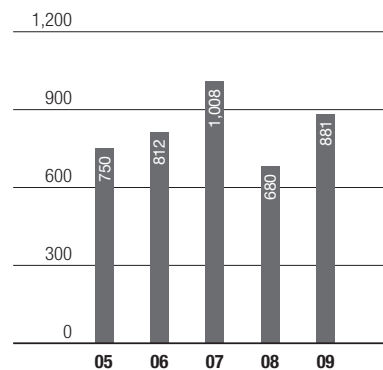


注記: 1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。

2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくはP22をご参照ください。

FPD/PV 製造装置売上高

(億円)



注記: 1. 2005年3月期より、従来、半導体製造装置部門売上高に含めていたFPD製造装置の売上を、半導体製造装置部門の売上高から分離して開示しています。

2. 2005年3月期に収益計上基準の変更を始めとする会計方針の変更を行いました。詳しくはP22をご参照ください。

電子部品・情報通信機器事業(東京エレクトロンデバイス株式会社*)

当セグメントの売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)は、前期比15.5%減少の947億円となりました。営業利益は49.7%減少の18億円、営業利益率は前期の3.3%から1.9%に低下しました。また、当セグメントの外部顧客に対する売上高は、前期比15.3%減少の942億円でした。

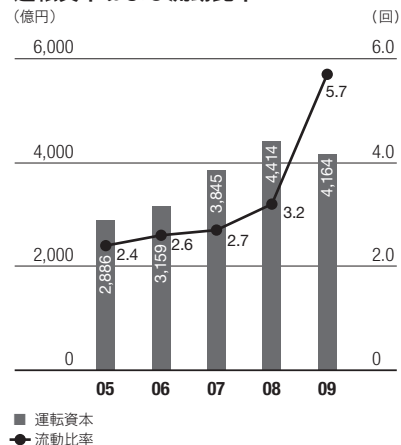
半導体及び電子デバイス事業分野では、期前半は携帯電話基地局向けカスタムICやPC向けメモリICが比較的堅調に推移しましたが、期後半に入ると急速な市場環境の悪化の中で売上は低調となりました。コンピュータシステム関連事業分野では、企業業績の悪化と景気に対する先行き不安から、設備投資を抑制する傾向が強まり、新規のIT投資が見送られる状況が続きました。

*東証2部上場

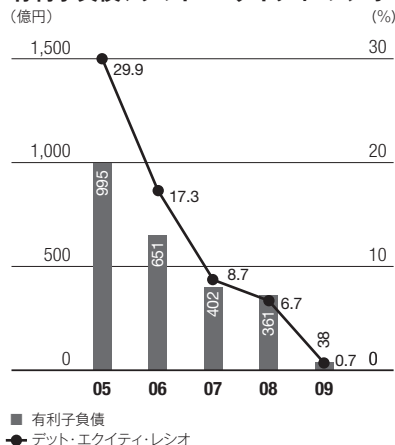
セグメント情報

2009:	百万円				
	産業用 電子機器	電子部品・ 情報通信機器	計	消去又は全社	連結
1. 売上高及び営業利益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	¥413,875	¥94,207	¥508,082	¥ -	¥508,082
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	942	495	1,437	(1,437)	-
合計	414,817	94,702	509,519	(1,437)	508,082
営業費用	401,974	92,861	494,835	(1,464)	493,371
営業利益	¥ 12,843	¥ 1,841	¥ 14,684	¥ 27	¥ 14,711
2. 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出					
資産	¥631,062	¥40,680	¥671,742	¥(2,744)	¥668,998
減価償却費	22,860	473	23,333	-	23,333
資本的支出(無形固定資産及びその他資産への支出を含む)	19,468	698	20,166	-	20,166

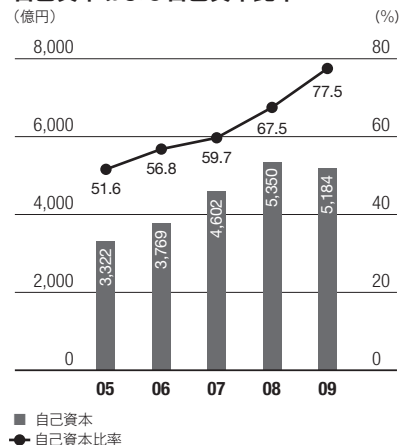
運転資本および流動比率



有利子負債、デット・エクイティ・レシオ



自己資本および自己資本比率



財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

2009年3月期末の総資産は、前期末から1,238億円減少の6,690億円となりました。

流動資産は、前期末比1,345億円減少の5,057億円となりました。これは、手元流動性（現金及び現金同等物+3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金）が2,102億円とほぼ前期並みの高水準を維持した一方、売上減少に伴って受取手形及び売掛金が1,045億円減少、また、たな卸資産も269億円減少したことによるものです。なお、受取手形及び売掛金回転日数は前期の90日から86日に縮まりましたが、たな卸資産回転日数は顧客からの納入遅延要求の影響もあり、65日から96日に伸びました。

有形固定資産は、新規取得分が181億円ありましたが、減価償却実施額231億円などを差し引き、ネットで42億円減少の999億円となりました。

投資その他の資産は、繰延税金資産が171億円増加したことなどにより、前期末比149億円増加の634億円となりました。

■ 負債及び純資産

負債は前期末比1,078億円減少の1,397億円となりました。

流動負債は、前期末比1,095億円減少の893億円となりました。これは、支払手形及び買掛金等の減少356億円、無担保社債300億円の償還、未払法人税等の減少265億円などによるものです。なお、有利子負債は短期借入金38億円のみとなり、これによりデット・エクイティ・レシオ（有利子負債／自己資本）は前期末の6.7%から0.7%に低下しました。

長期負債は、前期末比17億円増加の505億円でした。

純資産は、当期純利益75億円の計上による増加、配当金の支払い134億円による減少、評価・換算差額等の101億円の減少を主な要因として、前期比160億円減少の5,293億円となりました。この結果、自己資本比率は前期の67.5%から77.5%に上昇、自己資本当期純利益率（ROE）は前期の21.4%から1.4%に低下しました。

設備投資額*1および減価償却費*2

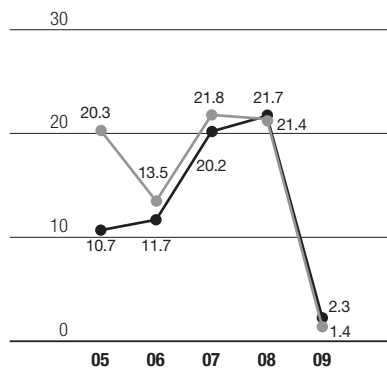
当期の設備投資額は、前期比20.2%減少の181億円となりました。設備投資の内容は、半導体製造装置およびFPD/PV製造装置の研究開発用の評価機・測定器の取得、建物設備の取得が主なものでした。減価償却費は7.7%増加の231億円でした。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。

*2 減価償却費にはのれんの減価償却額および追加償却額は含まれていません。

ROEおよびROA

(%)

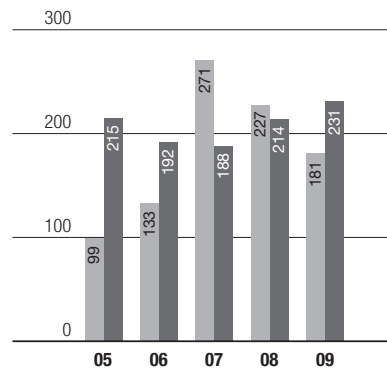


● ROE
● ROA

ROA = (営業利益 + 受取利息および受取配当金) / 期首・期末平均総資産 × 100

設備投資額および減価償却費

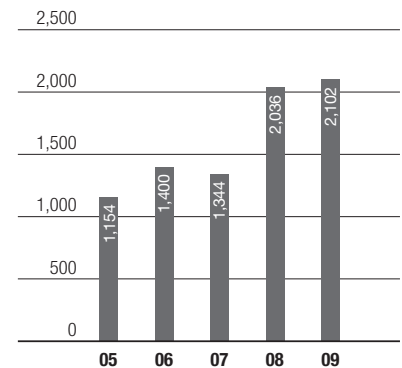
(億円)



■ 設備投資額
■ 減価償却費

手元流動性

(億円)



手元流動性 = 現金及び現金同等物 + 3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金

キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比360億円減少の810億円でした。主な内容としては、税金等調整前当期純利益96億円、減価償却費231億円、受取手形及び売掛金の減少1,024億円、たな卸資産の減少213億円がそれぞれキャッシュ・フローのプラス要因となった一方、支払手形及び買掛金の減少299億円、および法人税等の支払額408億円がキャッシュ・フローのマイナス要因となりました。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金の純増加額1,344億円、有形固定資産の取得による支出172億円などにより、前期の302億円に対し1,606億円となりました。

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、無担保社債300億円の償還、配当金の支払い134億円などにより、前期の270億円に対し460億円となりました。

これらの結果、2009年3月末の現金及び現金同等物の残高は、前期末の1,935億円から1,277億円減少し、659億円となりました。なお、現金及び現金同等物に3ヶ月超定期預金及び譲渡性預金を加えた手元流動性は、前期末の2,036億円から66億円増加し、2,102億円となりました。

事業などのリスク

当社の経営成績、財務状況および当社株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置などのハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加などの発生により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品および顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術などの最先端技術について積極的な研究開発投資および研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれなどの影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理などの各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しています。しかしながら、当社製品に関連する安全性などの問題により、顧客への損害発生、受注取消などが発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、およびレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用して頂くことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品であるなどの原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生するなどにより当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略および知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や知的財産権を回避する場合などがあるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっています。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としていますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約などによって為替リスクヘッジに努めています。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社の業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業におけるさらなる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社および他業種企業と同様に、世界および各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症などの不可抗力、金融・株式市場、政府などによる規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失などの影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。